InGaAs系高利得量子井戸 半導体レーザーの開発 及び評価測定

東京大学大学院理学系研究科 物理学専攻 小松原望

本発表内容は、機密事項の内容を含むため非公開扱いでの対応をお願いします。

目次

- 序論
- 実験方法
- 実験結果
- ・まとめ

目次

- 序論
 - 背景
 - 目的
- 実験方法
- 実験結果
- ・まとめ

背景

微細レーザー加工のためには扱いやすい短パルス光源が必要

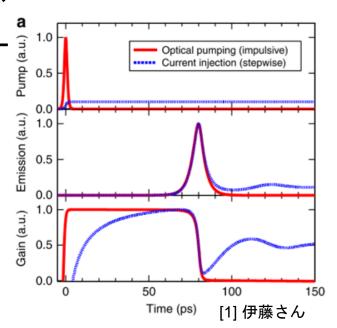
利得スイッチング短パルス半導体レーザー

- ✓ 小型・扱いが容易
- ✓高安定
- ✓印可電流の繰り返しで光パルスの繰り返し可変
- ✓基礎的なキャリアダイナミクスの物理に直結

応用上重要な利得スイッチング用電流注入型の半導体レー ザーの高速化に着目

<u>背景: 利得スイッチング</u>

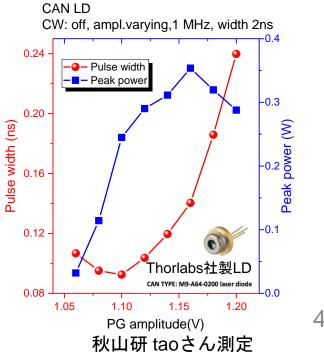
2準位系シングルモードレート方程式



電流注入利得スイッチング

	パルス幅
InGaAsP MQW DFB 1.55µm	4.7 ps[2]
商用デバイス(Thorlabs CAN type LD)	80~200 ps

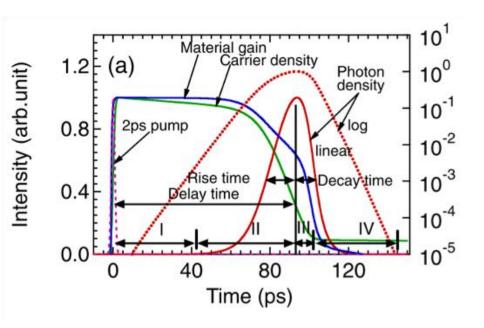
[2]Chenさん横山先生



背景: 利得スイッチング

2準位系シングルモードレート方程式

キャリア注入 誘導放出
$$\begin{bmatrix} +ャリア密度 & \frac{dn}{dt} & = & n_{\text{pump}}\zeta(t) - \frac{\Gamma}{m}\nu_{\text{g}}g(n)\frac{s}{1+\epsilon s} - \frac{n}{\tau_{r}} \\ \\ \text{光子密度} & \frac{ds}{dt} & = & \Gamma\nu_{g}g(n)\frac{s}{1+\epsilon s} - \frac{s}{\tau_{p}} + m\beta\frac{n}{\tau_{r}} \\ & + m\beta\frac{n}{\tau_{r}} \\ \\ + m\beta\frac{n}{\tau_{r}} \end{bmatrix}$$



パルス幅を決める要因

- ✓ モード利得の大きさ
 - →大きくしたい
- ✓ 共振器寿命
 - ✓ 短くしたい

背景:光パルスの高速化

パルス幅を決める要因

- ✓ モード利得の大きさ→大きくしたい
- ✓ 共振器寿命 →短くしたい



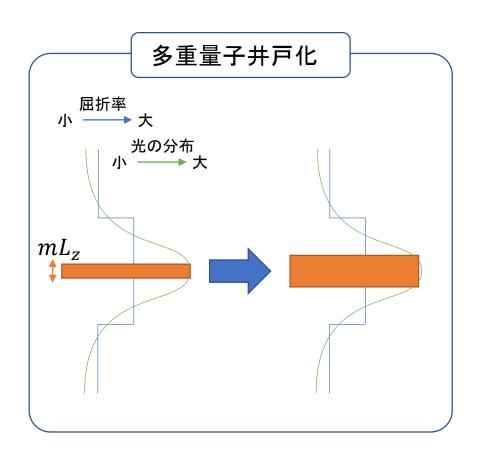
短パルス化

✓ 「gを大きくする →多重量子井戸化

$$\Gamma = mL_z/L_0$$

✓ Tpを小さくする →短共振器化

$$\tau_p = \frac{n_{\rm eq}}{c(\alpha + \ln(1/R)/L)}$$



背景: InGaAs系材料の多重量子井戸化

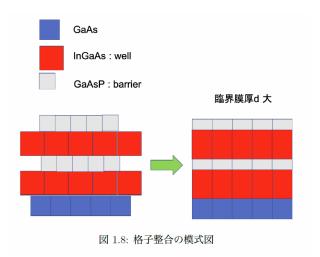
格子定数

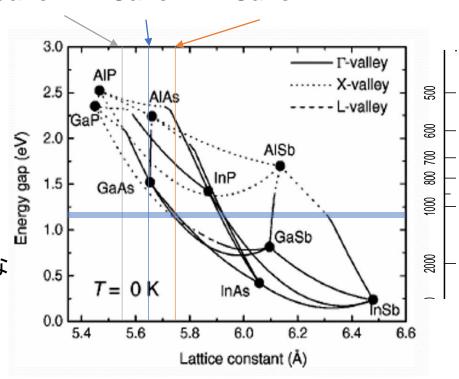
GaAsP < GaAs < InGaAs

1 µm波長帯発光材料・・・InGaAs

GaAs基板に格子整合させながら 厚く積むことができない

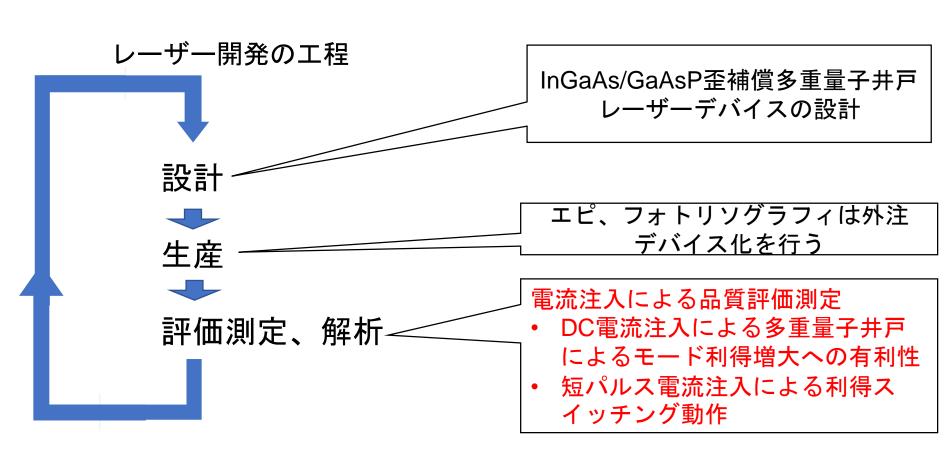
• GaAsPをバリア層として歪補償を行いながら多重化





本研究の目的

☆利得スイッチングパルスの高速化



目次

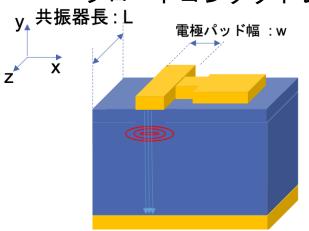
- 背景
- 実験方法
 - ✓試料構造
 - ✓測定方法
- 実験結果
- ・まとめ

E_g 屈折率n p-GaAs 200nm C: 1 × 10¹⁹ **Active layer** p-Al_xGaAs x:0.55→0.20 200nm C: 1 × 10¹⁸ pクラッド層^{oum} 3周期 p-Al_xGaAs x:0.55 1000nm C: 1 × 10¹⁸ In_{0.255}Ga_{0.745}As 15nm : well GaAs 12nm: barrier p-Al_xGaAs x:0.55 400nm C: 4×10^{17} well p-Al_xGaAs x:0.20→0.55 200nm C: 2×10¹⁷ barrier well p-GaAs 50nm C: 2 × 10¹⁷ barrier well p-In_xGaP x:0.485 100nm Zn : 2×10^{17} nonGaAs 120nm (SCH) コア層 10 周期 In_{0.255}Ga_{0.745}As 15nm: well **Active layer** GaAs_{0.71}P_{0.29} 10nm: barrier non-GaAs 100nm (SCH) well $n-Al_xGaAs x:0.55\to0.20200nm Si: \to 1\times10^{17}$ barrier $n-Al_xGaAs x:0.55 1400nm Si: 1 \times 10^{18}$ nクラッド層 $n-Al_xGaAs x:0.20\to0.55100nm Si: \to 1\times10^{18}$ n-GaAs 200nm Si :1-2 × 10¹⁸(Buffer) n-GaAs (Substrate)

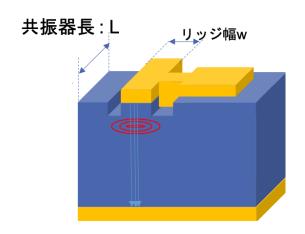
ウエハの結晶構造

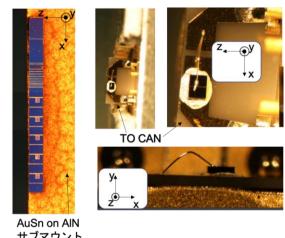
試料構造

ブロードコンタクトレーザー



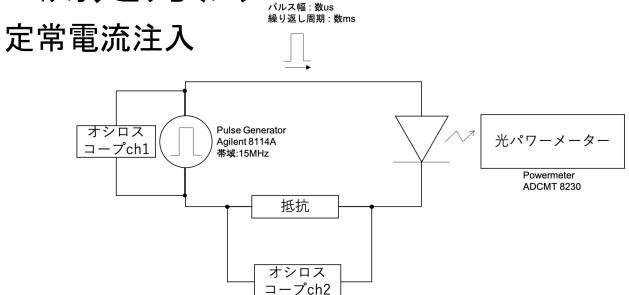
リッジ導波路型レーザー ・・・シングルモード化





サンプル

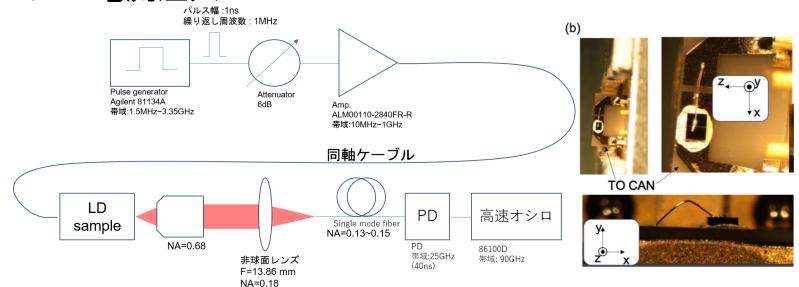
測定方法





AuSn on AIN サブマウント

短パルス電流注入

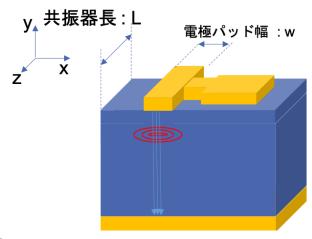


目次

- 背景
- 実験方法
- 実験結果
 - ✓ブロードコンタクトレーザー
 - ✓ 3周期
 - ✓10周期
 - ✓リッジ導波路型レーザー
 - √3周期
 - ✓10周期
- ・まとめ

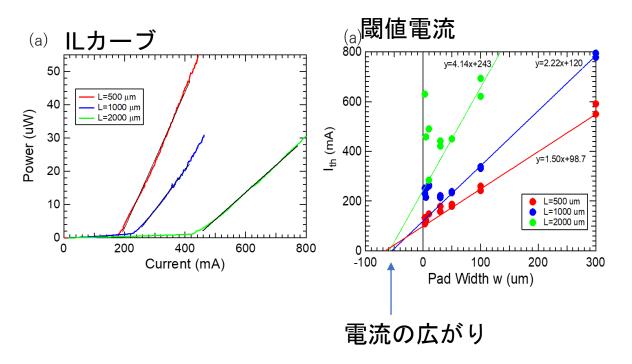
目次

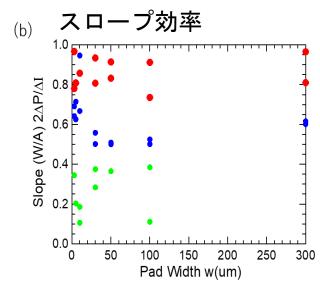
- 背景
- 実験方法
- 実験結果
 - ✓DC(ブロードコンタクト)
 - ✓DC注入 (リッジ導波路型)
 - ✓短パルス注入 (リッジ導波路型)
- ・まとめ



測定結果:DC ブロードコンタクト

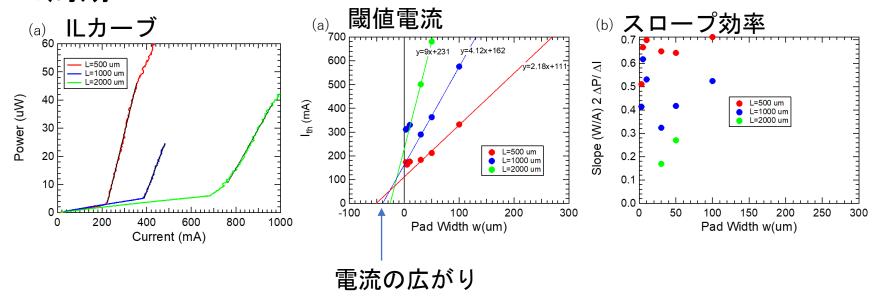
3周期





測定結果:DC ブロードコンタクト

10周期



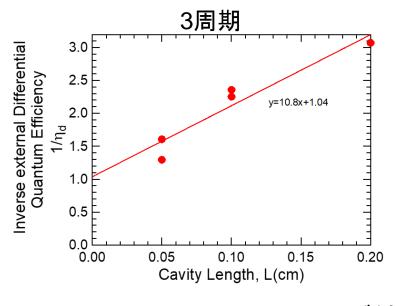
測定結果: ブロードコンタクトレーザー

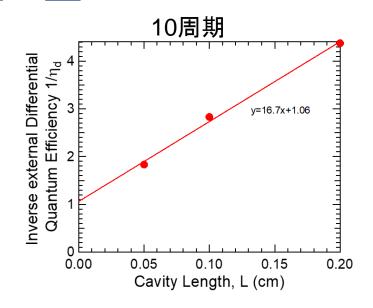
内部量子効率の見積もり

$$\eta_{\rm d} = \frac{e}{h\nu} 2\frac{\Delta P}{\Delta I}$$

$$\eta_{\rm d} = \eta_{int} \frac{\alpha_{int} + \alpha_{m}}{\alpha_{int} + \alpha_{m}}$$

$$\frac{1}{\eta_{\rm d}} = \frac{\alpha_{\rm int}}{\ln(1/R)\eta_{\rm int}} L + \frac{1}{\eta_{\rm int}}$$
切片



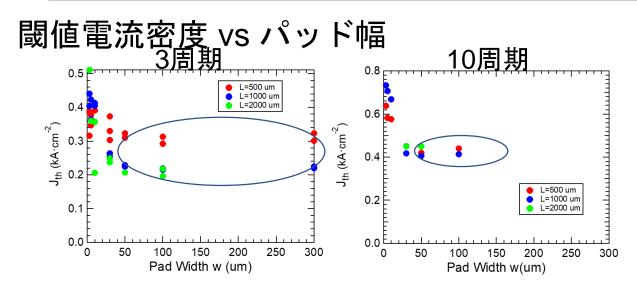


フィッティング結果

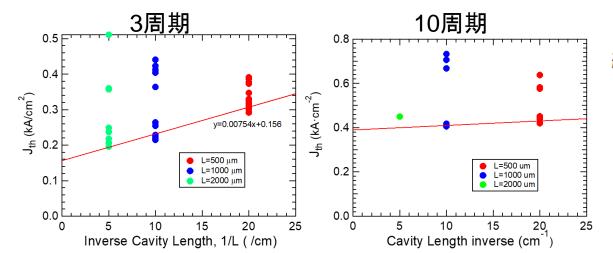
試料	内部損失 α_{int}/cm	内部量子効率 η_{int}
3周期	11.8	0.96
10 周期	18.0	0.94

歪補償を用いて発光効率の高い 良質な結晶を作製できた

測定結果:DC ブロードコンタクト



閾値電流密度 vs 共振器長の逆数



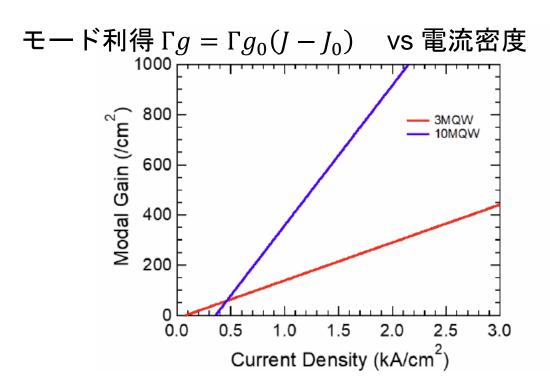
$$g_{
m net} = \Gamma G - lpha_{int} - lpha_{m}$$
線形利得 $G = g_{0}(J - J_{0})$ を仮定 $J_{th} = J_{0} + rac{lpha_{int}}{\Gamma g_{0}} + rac{1}{\Gamma g_{0}} \ln\left(rac{1}{
m R}
ight)$ 证 切片 傾き

18

測定結果: ブロードコンタクトレーザー

フィッティング結果

試料	透明電流密度 $J_0 \mathrm{kA/cm^2}$	$\Gamma g_0 / \mathrm{kA}$
3周期	0.0782	151
10 周期	0.357	558



ある電流密度以上では層数 が多いほうがモード利得を 稼ぐのに有利である。

測定結果: ブロードコンタクトレーザーまとめ

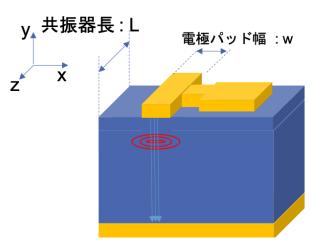
表 3.5: ブロードコンタクトレーザーの結果まとめ

試料	内部損失 α_{int}/cm	内部量子効率 η_{int}	透明電流密度 $J_0 \mathrm{kA/cm^2}$	$\Gamma g_0 / \mathrm{kA}$
3周期	11.8	0.96	0.0782	151
10 周期	18.0	0.94	0.357	558

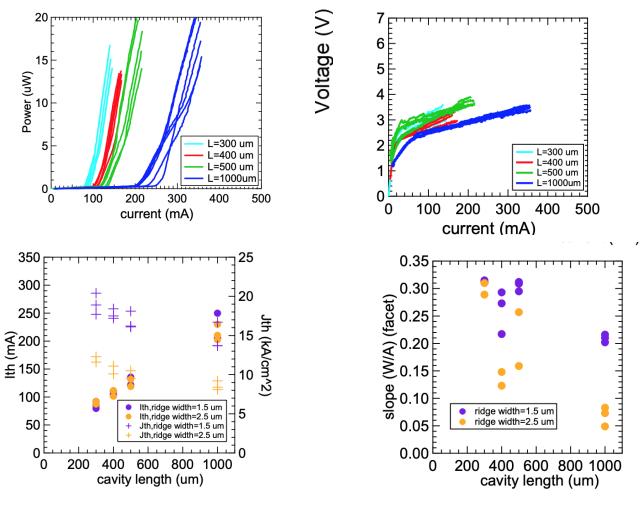
- ➤ 電流広がりが数十µmと見積もられた。
- ▶ 歪補償を用いて良質な結晶成長を行うことができた。
- ▶ 量子井戸の多重化によるモード利得増大への有利性を確認

目次

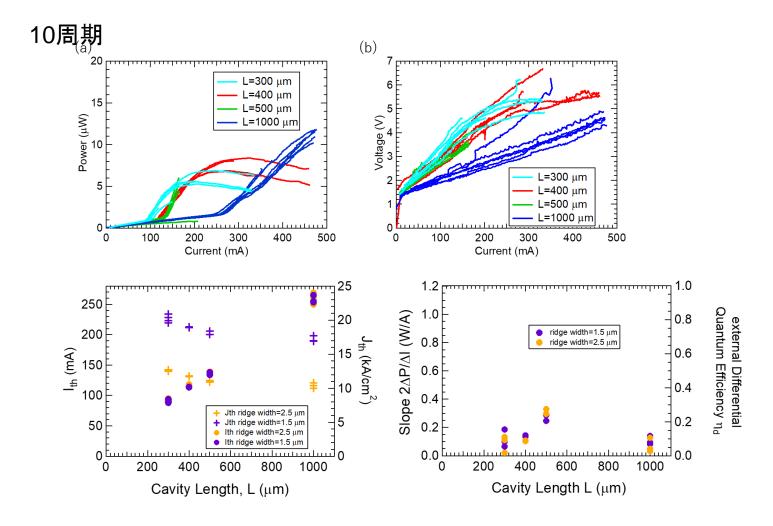
- 背景
- 実験方法
- 実験結果
 - ✓DC注入(ブロードコンタクト)
 - ✓DC注入 (リッジ導波路型)
 - ✓短パルス注入 (リッジ導波路型)
- ・まとめ



3周期



✓ 閾値電流が最短でも80 mAと高くなってしまった

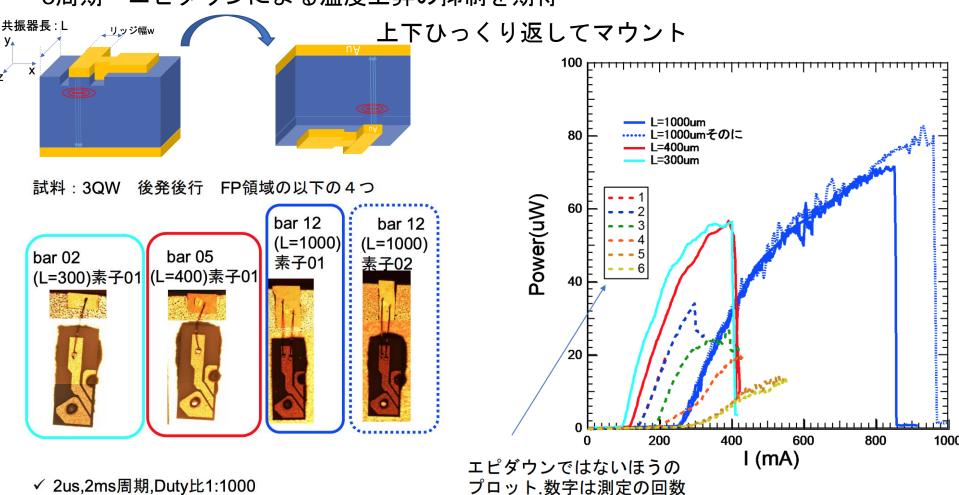


- ✓ Lカーブのが湾曲して発光強度が低下している →温度上昇による品質の低下
- ✓ リッジ幅による差異が見られない

- ・リッジ導波路型レーザーのLL測定で判明した課題
- ① 大電流を流すと発光強度が落ちる
- ② 閾値電流が高い。
- ③ リッジ幅依存性がない。

課題①大電流を流すと発光強度が落ちる

3周期 エピダウンによる温度上昇の抑制を期待



を表し,重ねるごとに発光量

が落ちていった

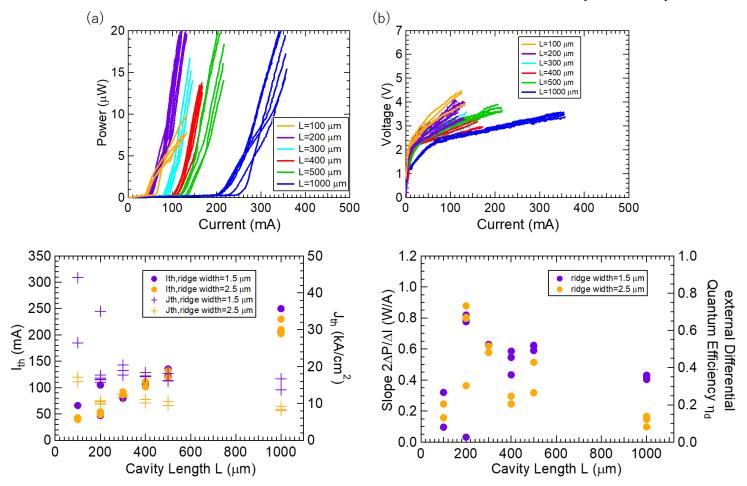
エピダウンしたことにより発光量の増加を確認した。

✓ 温調かけ忘れた

✓ パワーメータの設定波長: 1030nm

課題② 閾値電流が高い。

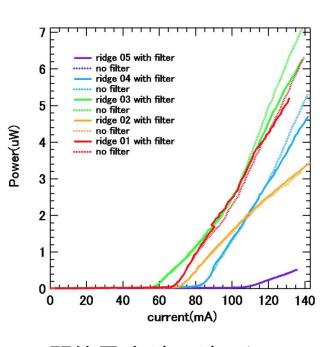
3周期 短共振器長レーザーデバイスの作製 L=100µm,200µmを追加

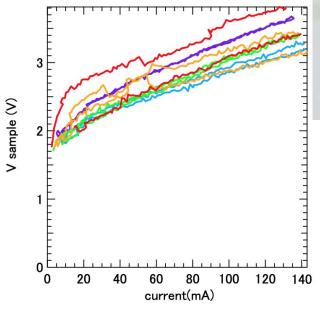


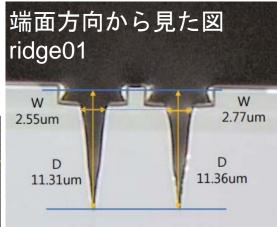
- ✓ 短共振器レーザー作製により閾値電流の低減達成 最短40mA
- ✓ リッジ幅による差異が見られない
 - →電流が広がってる?

課題③リッジ幅依存性がない。

FIB加工 3周期 L=300 μm, 2 μsパルス, 2 ms繰り返し, Duty比1:1000





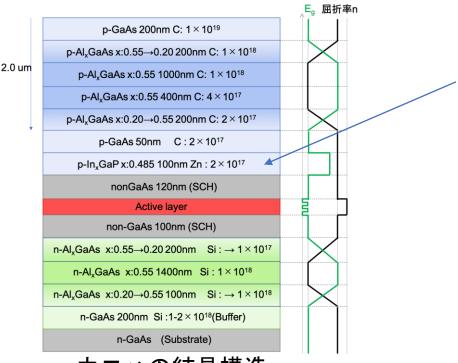


閾値電流が下がった

→電流が横方向に広がっていると推察

課題③リッジ幅依存性がない。

電流広がりの要因



エピ構造において バンドギャップの大きい p-InGaPが電流広がりの 原因

ウエハの結晶構造

まとめ

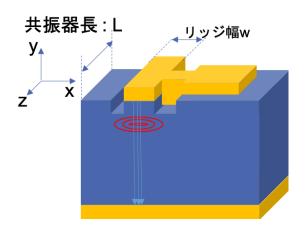
- リッジ導波路型レーザーのLL測定で判明した課題
- ① 大電流を流すと発光強度が落ちる ▶エピダウンによる光出力の向上
- ① 閾値電流が高い。 ➤短共振器による閾値電流の低減
- ② リッジ幅依存性がない。
 - ▶FIB加工試料の測定から電流が横方向に広がっていると推測
 - ▶InGaP層を薄くすることで解消しうる。

目次

- 背景
- 実験方法
- 実験結果

✓ブロードコンタクトレーザー

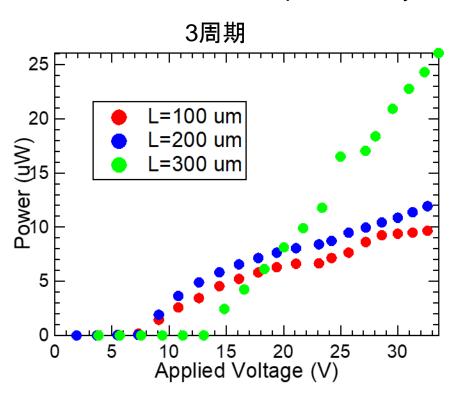
- ✓リッジ導波路型レーザー
 - ✓定常電流注入
 - ✓短パルス電流注入
- ・まとめ

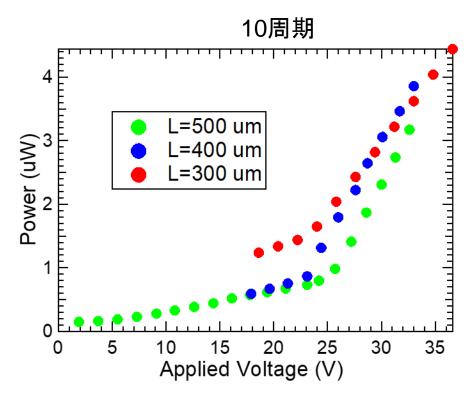


測定結果:リッジ導波路型レーザー 短パルス電流注入

LLカーブの結果

駆動条件: 1nsパルス, 1µs周期 Duty比1:1000





測定結果:リッジ導波路型レーザー 短パルス電流注入

16.6 (V)

Turni and transfer and transfer

time (ns)

3周期試料の結果 時間波形

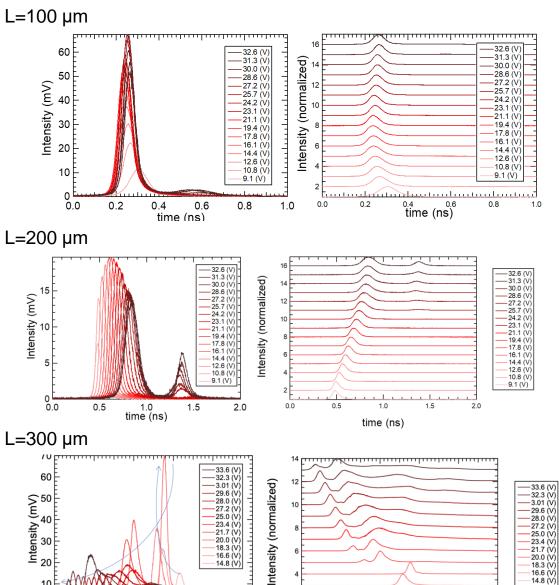
0.0

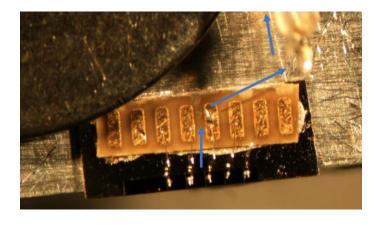
0.4

time (ns)

0.6

8.0





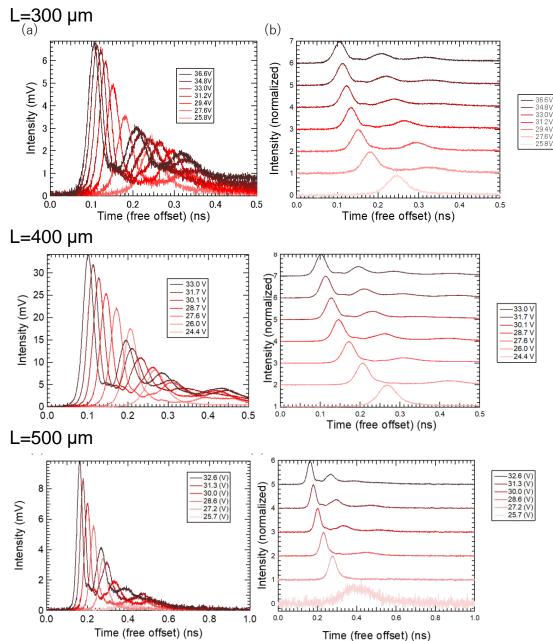
3周期試料の短パルス電流注入の様子 $(L=300 \mu m)$

励起強度を大きくしても立ち上がり が早くならない。ピーク強度も増加 しない。

→電気パルスが正しく印加されてい ない。インピーダンス不整合。

測定結果:リッジ導波路型レーザー 短パルス電流注入

時間波形 10周期試料の結果



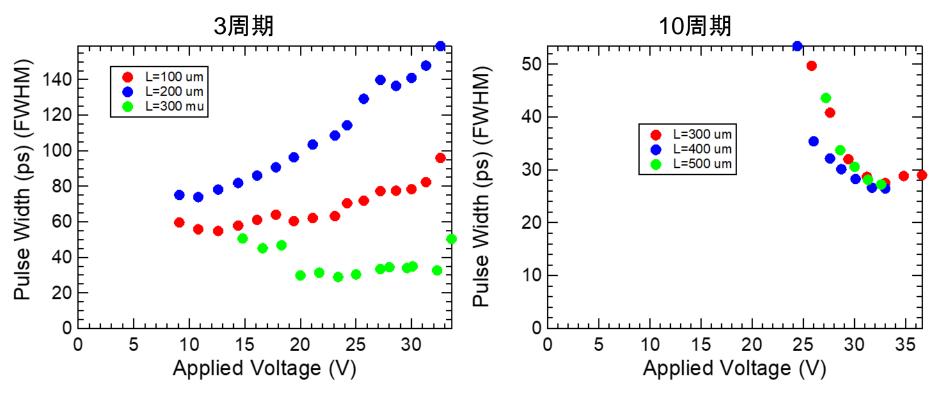


Can type

典型的な利得スイッチングパルス

測定結果: リッジ導波路型レーザー 短パルス電流注入

パルス幅



共振器長依存性が見られない 飽和

まとめ

